

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2023年10月5日(05.10.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/190321 A1

- (51) 国際特許分類:  
C09J 5/06 (2006.01) C09J 163/00 (2006.01)  
C09J 11/04 (2006.01) C09J 7/35 (2018.01)  
C09J 11/06 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)  
C09J 11/08 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/012170
- (22) 国際出願日: 2023年3月27日(27.03.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2022-055427 2022年3月30日(30.03.2022) JP
- (71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 森田 稔(MORITA, Minoru); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 大淵 俊弥(OHBUCHI, Shunya); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人イイダアンドパートナーズ, 外(IIDA & PARTNERS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: COMPOSITION FOR THERMALLY CONDUCTIVE FILM-LIKE ADHESIVES, THERMALLY CONDUCTIVE FILM-LIKE ADHESIVE, SEMICONDUCTOR PACKAGE USING THERMALLY CONDUCTIVE FILM-LIKE ADHESIVE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 熱伝導性フィルム状接着剤用組成物及び熱伝導性フィルム状接着剤、並びに、熱伝導性フィルム状接着剤を用いた半導体パッケージ及びその製造方法



(57) Abstract: The present invention provides a composition for thermally conductive film-like adhesives, the composition containing an epoxy resin (A), an epoxy resin curing agent (B), a polymer component (C), a polyhedral alumina filler (D) and a silane coupling agent (E), wherein: the proportion of the polyhedral alumina filler (D) in the sum of the respective contents of the epoxy resin (A), the epoxy resin curing agent (B), the polymer component (C), the polyhedral alumina filler (D) and the silane coupling agent (E) is 20% by volume to 70% by volume; and the addition factor of the silane coupling agent is 1.0 to 10. The present invention also provides: a film-like adhesive which uses this composition for thermally conductive film-like adhesives; a semiconductor package; and a method for producing a semiconductor package.

(57) 要約: エポキシ樹脂 (A)、エポキシ樹脂硬化剤 (B)、高分子成分 (C)、多面体状アルミナフィラー (D)、及びシランカップリング剤 (E) を含有し、前記エポキシ樹脂 (A)、前記エポキシ樹脂硬化剤 (B)、前記高分子成分 (C)、前記多面体状アルミナフィラー (D)、及び前記シランカップリング剤 (E) の各含有量の合計に占める前記多面体状アルミナフィラー (D) の割合が 20~70 体積% であり、シランカップリング剤配合倍数が 1.0~10 である、熱伝導性フィルム状接着剤用組成物、これを用いたフィルム状接着剤、半導体パッケージ及びその製造方法。

[続葉有]

MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,  
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,  
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,  
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,  
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,  
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,  
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,  
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）